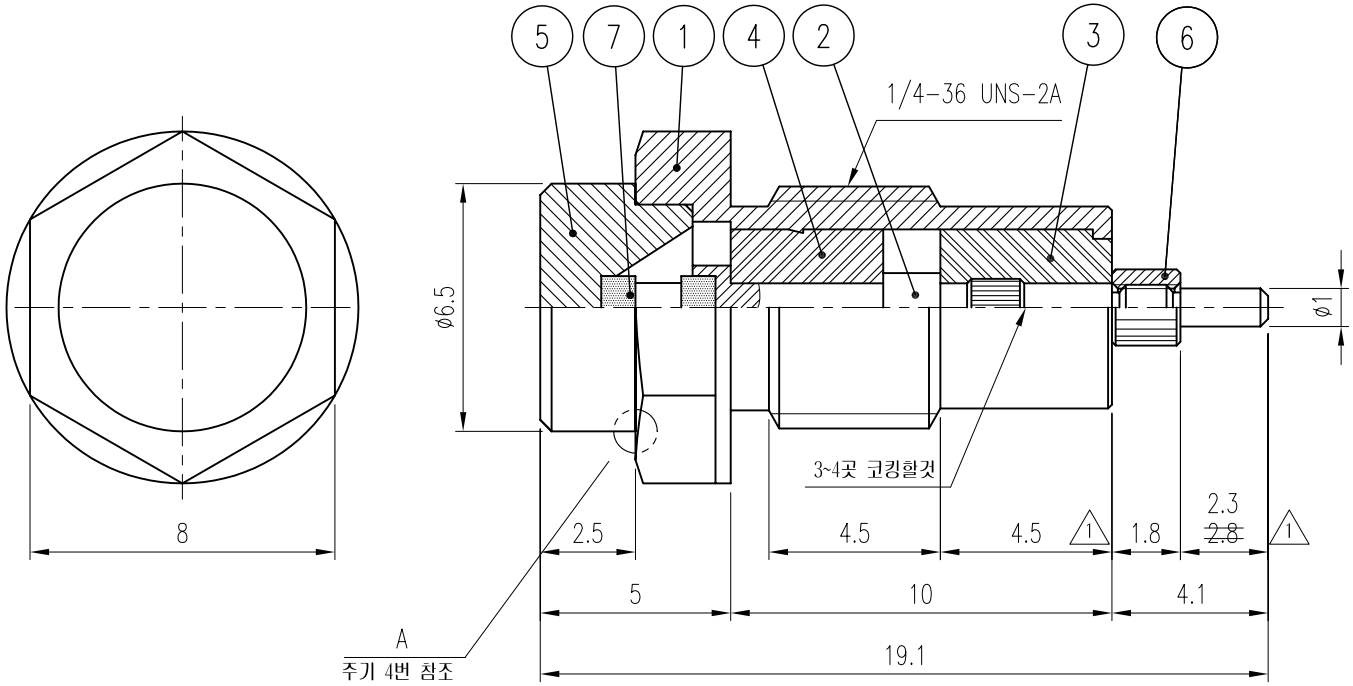
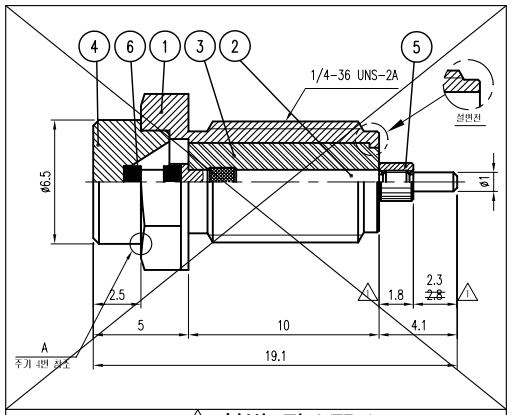
가공 / ST										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용

부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
1	[설변NO. 연구2007-067] 신뢰성 향상		윤상진	2007. 04. 03.
2	[설변NO. 연구2007-118] 조립성 향상	최유나	윤상진	2007. 07. 05.





2 설변 전 VER.1

	품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
	7	RESISTOR		1		DRE00057-N/1 (XA118)
1	6	INSERT	1	MBsBD	Gold Plate	DIS00108-5/1 (M2022)
	5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCV00013-5/1 (L2032)
2	4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01124-N/1 (H2379)
2 1	3	INSULATOR	1	TEFLON		~~H2346~~ DIN00216-N/1 (H2261)
2 1	2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01313-5/1 (E2555)
2 1	1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	~~D2496~~ DBD01686-5/1 (D2549)

조 립 주 기

1. 절연체에 PIN을 밀어 넣어 조립한다.
2. 조립된 절연체를 BODY에 끼운다.
3. 저항을 삽입한다.
4. COVER를 억지끼움한다. <표시 A부분 밀착 시킬 것.>
5. 4번까지 조립된 상태에 NUT를 나사 체결 후 PIN 길이를 확인한다.
   (LOC TITE를 바른다.)
6. 멀티미터기로 순수 저항 값을 측정할 것.
   <저항값 48~52Ω>

대체가능재질	년월일	2007. 3. 19.	KJ COMTECH / KJ COMTECH CO.,LTD. — RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
공통공차 .* ±0.1 .** ±0.05	승인		
	검도		도명 SMA-J-내장형 TERM VER.2
재질	제도		
열처리	작성부서	연 구 소	A4 도번 TM00030-7/1
보호피막처리	척도 5/1	단위 mm	중량 — K314-953-005